

信义山证汇通天下

证券研究报告

电子

周跟踪（20231113-20231119）

领先大市-A(维持)

——英伟达发布新一代人工智能芯片 H200，台积电加快 CoWoS 产能扩充

2023 年 11 月 20 日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源：最闻

相关报告：

【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：
首款无屏幕可穿戴设备发布，AI 硬件领域融合创新加速 2023.11.13

【山证电子】2023 年三季报总结：周期
筑底景气度不减，看好半导体复苏和消
费电子板块机会 2023.11.9

分析师：

高宇洋

执业登记编码：S0760523050002

邮箱：gaoyuyang@sxzq.com

徐怡然

执业登记编码：S0760522050001

邮箱：xuyiran@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体：**本周（2023.11.13-2023.11.19）市场大部分上涨，上证指数涨 0.51%，深圳成指涨 0.01%，创业板指数跌 0.93%，科创 50 涨 0.18%，申万电子指数涨 0.86%，Wind 半导体指数跌 0.03%，费城半导体指数涨 4.37%，台湾半导体指数涨 4.35%。细分板块中，周涨跌幅前三大板块：**其他电子(+5.27%)**、**光学光电子(+1.71%)**、**数字芯片设计(+1.66%)**。个股情况看，涨幅前五：**凯华材料(+50.65%)**、**西陇科学(+48.13%)**、**协创数据(+39.27%)**、**宏昌电子(+30.82%)**、**华海诚科(+27.49%)**；跌幅前五：**富乐德(-12.44%)**、**昀冢科技(-11.75%)**、**甬矽电子(-9.06%)**、**捷荣技术(-8.89%)**、**春秋电子(-8.64%)**。

➢ **行业新闻：**晶圆代工成熟制程厂商面临产能利用率六成保卫战。联电、世界先进及力积电等为抢救产能利用率，大砍明年首季报价，幅度达二位数百分比，专案客户降幅更高达 15%至 20%，借此“以价换量”。**台积电为应对客户需求加快 CoWoS 先进封装产能扩充脚步：**台积电明年月产能将比原订倍增目标再增加约 20%达 3.5 万片，同时进一步对设备厂商追加订单，预期明年上半年开始装机并进入试产，下半年开始投入产能。**英伟达发布新一代人工智能芯片 H200：**H200 芯片是当前用于训练最先进大语言模型 H100 芯片的升级产品，也是 HBM3e 内存的芯片。H200 容量几乎是 A100 两倍，带宽增加了 2.4 倍。H200 性能较 H100 提高 60%至 90%。H200 预计将于 2024 年第二季度上市。

➢ **重要公告：【兴森科技】**11 月 13 日公告，基于公司整体发展战略规划，公司以挂牌底价 3 亿元购买控股子公司所持有的广州兴科 25%股权。**【晶晨股份】**11 月 14 日公告，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计拟派发现金红利 2.08 亿元（含税），占前三季度归母净利润 66.35%。**【甬矽电子】**11 月 14 日公告，基于公司长远发展战略，为提升公司核心竞争力，公司投资建设高密度及混合集成电路封装测试项目，投资总额不超过 21.57 亿元。

投资建议

➢ 23Q3 电子行业基本面持续改善，结合 Q4 和明年 Q1 指引，消费电子景气度有望持续。展望明年，AI 相关芯片需求强劲，对 CoWoS、HBM 等先进封装拉动较大，台积电等厂商也在积极布局。中长期看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI 新技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

风险提示

➢ 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。



请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明

1

目录

1. 行情回顾.....	4
1.1 市场整体行情.....	4
1.2 细分板块行情.....	4
1.2.1 涨跌幅.....	4
1.2.2 估值.....	5
1.3 个股公司行情.....	6
1.4 大厂景气度.....	6
2. 数据跟踪.....	11
3. 新闻公告.....	15
3.1 重大事项.....	15
3.2 行业新闻.....	16
3.3 公司公告.....	17
4. 风险提示.....	22

图表目录

图 1： 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	4
图 2： 周涨跌幅其他电子、光学光电子、数字芯片设计表现领先.....	4
图 3： 月涨跌幅其他电子、数字芯片设计、分立器件表现领先.....	5
图 4： 年初至今涨跌幅集成电路封测、光学光电子、消费电子表现领先.....	5
图 5： 半数板块当前 P/E 低于历史低位.....	5
图 6： 多数板块当前 P/B 处于历史低位.....	5
图 7： 本周个股涨幅前五.....	6
图 8： 本周个股跌幅前五.....	6

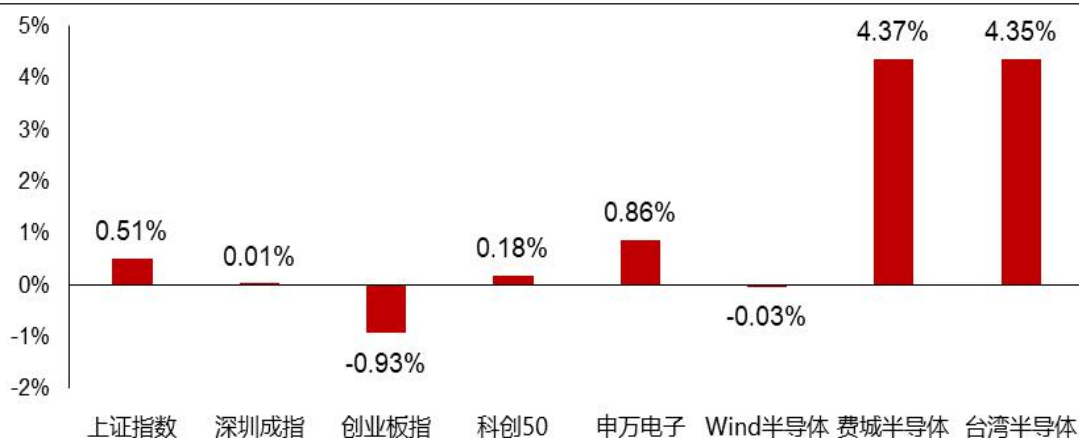
图 9: 全球半导体月度销售额及增速.....	11
图 10: 分地区半导体销售额.....	11
图 11: 中国集成电路行业进口情况.....	11
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	11
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	11
图 14: 北美半导体设备销售额.....	11
图 15: 日本半导体设备销售额.....	12
图 16: 全球硅片出货面积.....	12
图 17: NAND 现货平均价.....	12
图 18: DRAM 现货平均价.....	12
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	12
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	12
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	13
图 22: 晶圆厂稼动率 (%)	13
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)	13
表 1: 大厂最新指引.....	6
表 2: 主要半导体产品货期.....	14
表 3: 主要半导体公司存货周转天数.....	14
表 4: 主要半导体公司毛利率情况.....	15
表 5: 本周重大事项.....	15
表 6: 本周重要行业新闻.....	16
表 7: 本周重要公司公告.....	17

1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周（2023.11.13-2023.11.19）市场大部分上涨，除创业板指数跌 0.93%、Wind 半导体指数跌 0.03%外，上证指数涨 0.51%，深圳成指涨 0.01%，科创 50 涨 0.18%，申万电子指数涨 0.86%，费城半导体指数涨 4.37%，台湾半导体指数涨 4.35%。

图 1：主要大盘和电子指数周涨跌幅

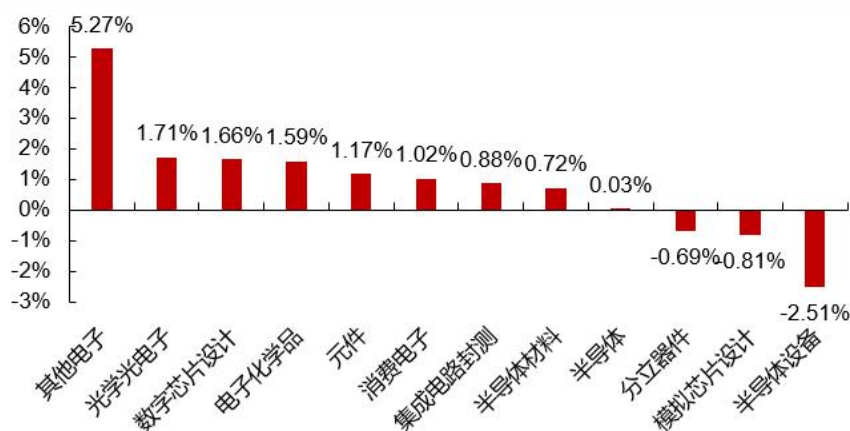


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.2 细分板块行情

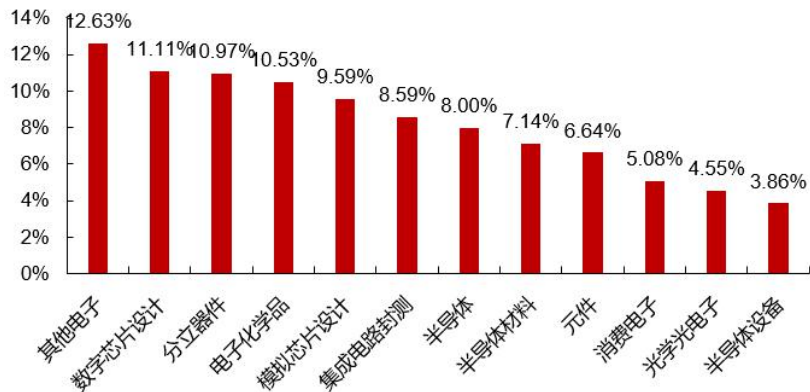
1.2.1 涨跌幅

图 2：周涨跌幅其他电子、光学光电子、数字芯片设计表现领先



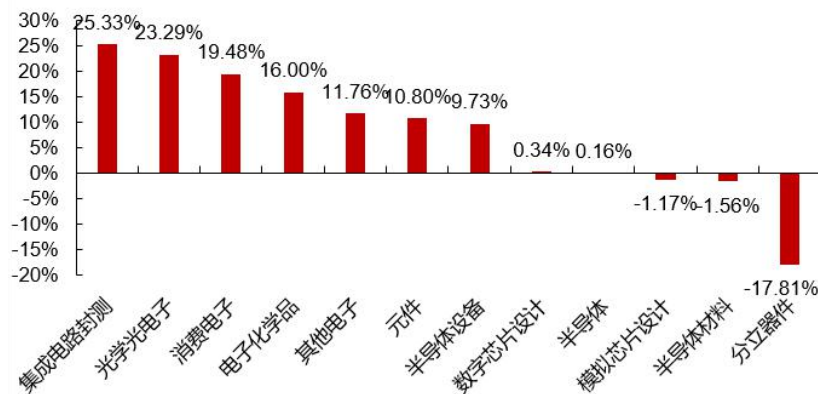
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 3：月涨跌幅其他电子、数字芯片设计、分立器件表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

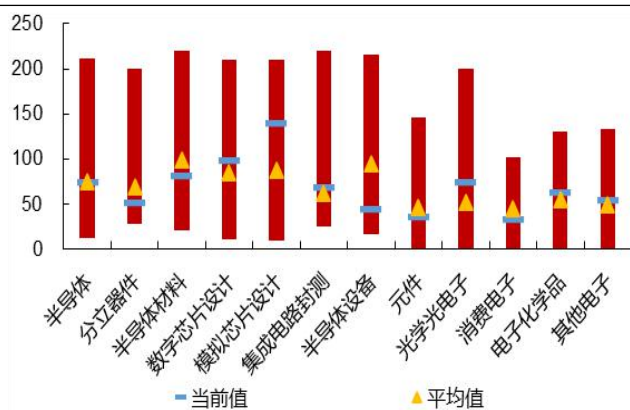
图 4：年初至今涨跌幅集成电路封测、光学光电子、消费电子表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

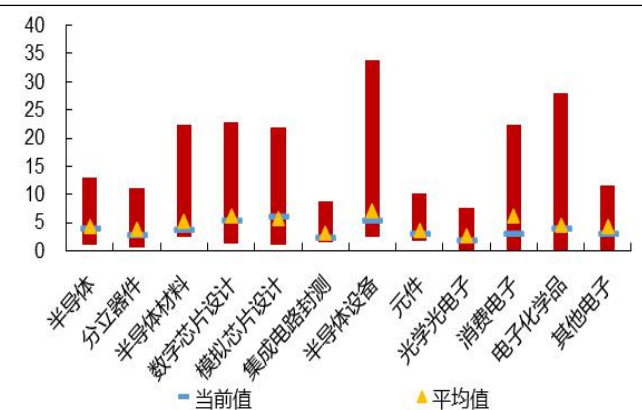
1.2.2 估值

图 5：半数板块当前 P/E 低于历史低位



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 处于历史低位

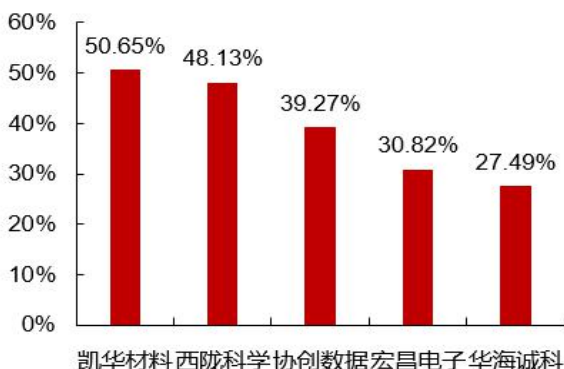


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.3 个股公司行情

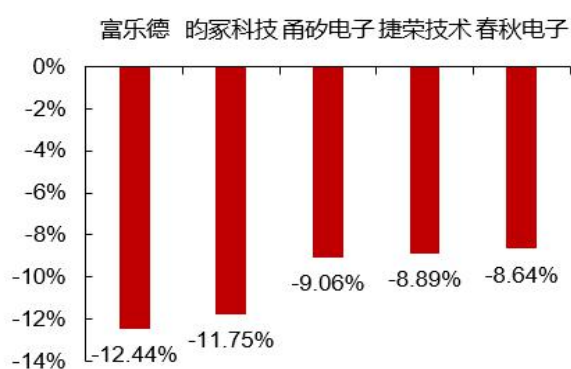
从个股情况看，凯华材料、西陇科学、协创数据、宏昌电子、华海诚科涨幅领先，涨幅分别为 50.65%、48.13%、39.27%、30.82%、27.49%。富乐德、昀冢科技、甬矽电子、捷荣技术、春秋电子跌幅居前，跌幅分别为-12.44%、-11.75%、-9.06%、-8.89%、-8.64%。

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

1.4 大厂景气度

表 1：大厂最新指引

板块	公司	财年	时期	景气度
存储	美光	23Q4	23.6-23.8	FY23Q4 实现营收 40 亿美金，同比增长 7%，环比下降 40%，FY23 实现营收 455 亿美金，环比下降 49%。HBM3E 客户反应强烈，预计 CY24 年初量产并实现营收。高容量 D5 已向客户交付样品，预计 CY24 年初 D5 销量超过 D4，并于 CY24Q2 实现营收。8 月推出 128 和 256GB 的 CXL 2.0 内存扩展模块，并向客户交付样品。预计 CY23 PC 销量同比下滑低双位数，预计 CY23 智能手机销量同比下滑中个位数，CY23 汽车业务收入创下历史新高，CY23Q4 工业市场出现复苏迹象，预计该迹象将延续到 CY24。CY23，DRAM 预期增长中低个位数，NAND 预期增长高十位数。本财季 DRAM 价格环比下滑高个位数，NAND 价格环比下滑 15-17%。FY24 资本开支将略高于 FY23 水平。
	SK 海力士	23Q3	23.7-23.9	FY23Q3 实现营收 9.0662 万亿韩元，环比增加 24%，营业亏损为 1.7920 万亿韩元，营业亏损环比增加 38%，净亏损为 2.1847 万亿韩元。FY23Q3 营业亏损率为 20%，净亏损率为 24%。因高性能半导体存储器产品为中心的市场需求增加，公司业绩在第一季度低点过后持续改善，特别是 HBM3、高容量 DDR5 DRAM 和高性能移动 DRAM 等主力产品的销售势头良好，与上季度相比营业收入增长 24%，营业损失减少 38%。DRAM 得益于 AI 等高性能面向服务器的产品销售好转，与第二季度相比出货量增长了约 20%，与此同时 ASP 也上升了约 10%。NAND 闪存在高容量移动端产品和固态硬盘的出货量有所增加。SK 海力士决定于今年下半年加大对 HBM、DDR5、LPDDR5 DRAM 等高附加值主力产品的投资。公司将进行以第四代 10 纳米

				级(1a)和第五代 10 纳米级(1b)DRAM 为中心的生产线转换,同时扩大对 HBM TSV1 技术的投资。
MCU	NXP	23Q3	23.7-23.9	2023Q3 公司营收 34.3 亿美元,上年同期 34.45 亿美元,同比减少 0.3%,略高于市场预期 34 亿美元;净利润 7.87 美元,略高于预期 7.59 美元;调整后每股收益 3.7 美元,略高于预期 3.59 美元。按业务划分,汽车业务营收 18.9 亿美元,上年同期 18.04 亿美元,同比增长 5%;工业及物联网业务营收 6.07 亿美元,上年同期 7.13 亿美元,同比下滑 15%;移动设备业务营收 3.77 亿美元,上年同期 4.10 亿美元,同比下滑 8%,上季度营收 8.71 亿美元,环比增长 33%,表明智能手机需求有所复苏;通信基础设施及其他业务营收为 5.59 亿美元,2023Q2 营收 5.71 亿美元,环比下滑 2%,上年同期营收 5.18 亿美元,同比增长 8%。展望未来,公司预计四季度调整后每股收益 3.44-3.86 美元,市场预期 3.61 美元。预计四季度营收 33 亿-35 亿美元,市场预期 34.2 亿美元。公司首席执行官表示,在充满挑战和周期性的市场环境中,2023 年全年营收将与 2022 年持平。
	ST	23Q3	23.7-23.9	2023Q3 意法半导体第三季度营收同比增长 2.5%至 44.3 亿美元,超出市场预期的 43.8 亿美元;净利润为 10.9 亿美元,同比减少 0.8%;eps 为 1.16 美元。分业务来看,汽车和功率器件业务同比增长,收入 20.25 亿美元。模拟 IC、MEMS 和 CIS 业务同比减少,收入 9.90 亿美元。射频通信业务同比增长,MCU 业务同比持平,收入 14.12 亿美元。意法半导体首席执行官 Jean-Marc Chery 表示,第三季度净营收同比增长 2.5%。正如预期,汽车业务持续增长是拉动营收的主要动力,而个人电子产品收入下滑抵消了部分增长空间。意法半导体预计第四季度净营收 43.0 亿美元,环比下降约 3%,上下浮动 350bps,毛利率约 46%,上下浮动 200bps。
	微芯	24Q2	23.7-23.9	FY24Q2 实现营收 22.54 亿美金,同比增长 8.73%,环比减少 1.5%,低于市场预期 22.65 亿美金;净利润为 6.67 亿美元,超过市场预期 6.62 亿美元;每股收益 1.21 美元,超过市场预期 1.2 美元。公司首席执行官表示,公司第二财季的业绩符合指导目标。由于全球所有地区和大多数终端市场都经历了不同程度的疲软,收入环比下降了 1.5%。指引方面, FY24Q3 净销售 18 亿-19.2 亿美元,低于分析师预期 21.1 亿美元;净利润为 3.71-4.14 亿美元;资本支出预计 5000-7000 万美元;24 财年全年资本支出 3-3.25 亿美元。
模拟 IC	TI	23Q3	23.7-23.9	2023Q3 营收 45.3 亿美元,同比下降 14%,低于市场预期的 45.8 亿美元;利润为 18.9 亿美元,同比下降 29%;净利润为 17.1 亿美元,同比下降 26%,低于市场预期 16.6 亿美元;每股收益为 1.85 美元,同比下降 25%,仍好于市场预期的 1.82 美元;资本支出为 15 亿美元,高于上年同期的 7.9 亿美元。其中,模拟芯片(Analog)业务收入 33.53 亿美元,同比下降 16%。首席执行官表示,本季度汽车业持续增长,工业疲软加剧。指引方面,公司预计 Q4 营收将在 39.3 亿至 42.7 亿美元之间,低于分析师平均预期 44.9 亿美元;每股收益 1.35 至 1.57 美元,低于分析师预期 1.76 美元。
	ADI	23Q3	23.5-23.7	FY2023Q3, ADI 营收 30.76 亿美元,同比下滑 1%。GAAP 毛利率 63.8%,去年同期 65.7%,非 GAAP 毛利率 72.2%,去年同期 74.1%。GAAP 每股摊薄收益 1.74 美元,去年同期 1.44 美元,非 GAAP 每股摊薄收益 2.49 美元,去年同期 2.52 美元。分部门来看,工业部门营收 16.29 亿美元,同比增长 4%。汽车部门营收 7.48 亿美元,同比增长 15%。通信部门营收 3.81 亿美元,同比下滑 23%。消费者部门营收 3.19 亿美元,同比下滑 21%。展望 FY2023Q4, ADI 预计营收约为 27 亿美元,上下浮动 1 亿美元。基于这一预期的中间点,公司预计鉴于广泛的库存调整,所有市场都将环比下滑。相对而言,汽车和消费板块应该比工业和通信板块表现好一些。
射频	Qorvo	24Q2	23.7-23.9	按公认会计原则计算, Qorvo 2024 财年第二季度营收为 11.03 亿美元, 环比增长

IC				70%，比收入指导的中点高出 1.03 亿美元，毛利率为 44.4%，营业收入为 1.51 亿美元，每股摊薄收益为 0.99 美元。指引方面 2024 财年第三季度预计营收 10 亿美元（±2500 万美元），Qorvo 首席财务官表示“展望未来，我们 12 月份的季度指引反映了季节性规律、客户项目的强劲内容以及渠道库存的改善。预计 2024 财年的收入将实现同比增长。”
	博通	23Q3	23.5-23.7	FY23Q3 实现营收 88.76 亿美元，上年同期为 84.64 亿美元，同比增长 5%。季度净利润 33.03 亿美元，上年同期为 30.74 亿美元，同比增长 7.5%。其中，半导体业务营收 69.41 亿美元，上年同期为 66.24 亿美元，同比增长 5%，略低于市场预期 69.7 亿美元。软件业务营收 19.35 亿美元，上年同期为 18.4 亿美元，同比增长 5%，高于市场预期 18.9 亿美元。指引方面，FY23Q4 预计营收同比增长 4%至 92.7 亿美元，略低于分析师预期的 92.8 亿美元；经调整后的 EBITDA 利润率预估约 65%。公司首席执行官表示，博通第三季度的业绩是由对下一代网络技术的需求推动的，因为超大规模客户扩大了他们的人工智能集群，并在数据中心内建立了网络，第四季度展望预计将实现同比增长，反映出在生成人工智能网络方面的持续领先地位。
	skyworks	23Q4	23.7-23.9	2023 财年第四财季公司营收为 12.19 亿美元，上年同期为 14.07 亿美元，同比减少 13.36%。按照美国通用会计准则，第四财季营业收入为 2.54 亿美元，上年同期 3.88 亿美元，同比减少 34.54%；摊薄后每股收益为 1.52 美元，上年同期 1.88 美元，同比减少 19.15%。公司首席执行官表示，尽管面临宏观经济的不利因素，Skyworks 仍然取得了稳健的业绩，并在 2023 财年创造了远超 16 亿美元的创纪录自由现金流，同比增长 76%。展望未来，预计 12 月季度公司营收在 11.75-12.25 亿美元之间，非美国通用会计准则摊薄后每股收益为 1.95 美元，移动业务将出现良好的发展势头，并将继续消化部分细分市场的过剩库存。
AI 芯片	英伟达	24Q2	23.5-23.7	FY24Q2 英伟达收入达到 135.1 亿美元，大幅超过了一季度的业绩指引，同比增长 101%，环比增长 88%。受益于 AI 需求，本季度数据中心业务收入达到 103.2 亿美元，环比增长 141%，同比增长 171%，在总收入的占比达到了 76.4%。除数据中心业务，本季度的第二大业务游戏也迎来了业绩回暖，收入达到 24.86 亿美元，同比增长 21.7%。FY24Q3 指引净利润预计约为 73.4 亿美元，较本季度净利润环比增长 18.6%，净利率水平维持在 45.8% 的高位。
	AMD	23Q3	23.7-23.9	2023Q3 营收为 58 亿美元，同比增长 4%，高于市场预期 57.1 亿美元，净利润为 2.99 亿美元，同比增长 353%，调整后每股收益为 0.18 美元，同比增长 350%。分业务来看，报告期内 AMD 数据中心事业部营业额为 16 亿美元，环比增长 21%，客户端事业部营业额为 15 亿美元，同比增长 42%，PC 业务部三季度营收 14.5 亿美元，同比增长 42%，游戏事业部营业额为 15 亿美元，同比下降 8%，嵌入式事业部营业额为 12 亿美元，同比下降 5%。公司第三季度实现了强劲的收入和盈利增长，主要得益于 Ryzen 7000 系列 PC 处理器的需求增长和创纪录的服务器处理器销售。业绩指引方面，AMD 预计四季度营收将达到 58 亿美元至 64 亿美元之间，预计为 61 亿美元，低于市场此前预期的 64 亿美元。
功率半导体	英飞凌	23Q4	23.7-23.9	英飞凌 2023 财年 Q4 营收 41.49 亿欧元，同比增长 0.14%，环比增长 1.47%，超过指引预期（40 亿欧元）；毛利率 43.6%，同比减少 0.8pct，环比减少 0.9pct；利润达 10.44 亿欧元，利润率为 25.2%。2023 财年整体营收为 163.09 亿欧元，同比增长 15%；利润达 43.99 亿欧元，同比增长 30%；利润率为 27%。分部门来看，ATV 部门 FY23Q4 营收 21.62 亿欧元，同比增长 11.79%，环比增长 1.55%；GIP 部门营收 5.82 亿欧元，同比增长 7.38，环比增长 3.01%；CSS 部门营收 4.19 亿欧元，同比减少 0.41%，环比增加 3.38%；PSS 部门营收 9.12 亿欧元，同比减少 21.98%，

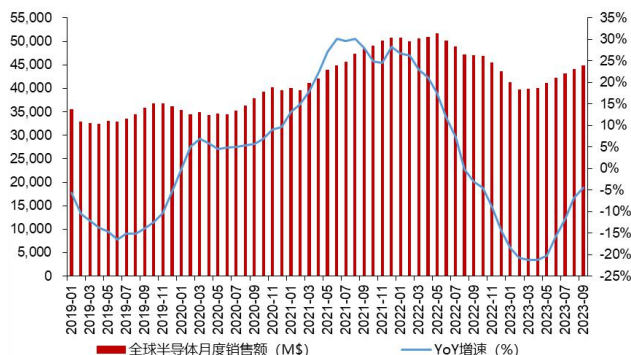
				环比减少 0.55%。指引方面, FY24Q1 预计营收约 38 亿欧元, 利润率预计将达到 22%左右, 2024 财年预计营收约为 170 亿欧元(±5 亿欧元), 如果营收为预测区间的中点, 则利润率约为 24%, 预计投资额将达到 33 亿欧元。
	安森美	23Q3	23.7-23.9	2023Q3 营收为 21.8 亿美元, 同比下降 0.54%, 高于分析师预期 21.5 亿美元; 归母净利润为 5.8 亿美元, 同比增长 86.82%; 调整后每股收益 1.39 美元, 同比下降了 4.14%, 超出市场预期的 1.34 美元; GAAP 准则下毛利率为 47.3%, 低于上年同期 48.3%; 营业利润率为 31.5%, 高于上年同期 19.4%。分部门来看, 创纪录的汽车收入为 12 亿美元, 同比增长 33%; 创纪录的工业收入为 6.16 亿美元, 同比略有增长。展望未来, 预计第四季度收入为 19.50-20.50 亿美元, 低于市场预期 21.8 亿美元, 调整后每股收益为 1.13-1.27 美元, 低于市场预期 1.36 美元。
	wolfspeed	24Q1	23.7-23.9	FY24Q1 实现营收 1.974 亿美元, 上年同期 1.89 亿美元, 同比增长 4.2%, 基本符合市场 1.96 亿美元预期; 净亏损 4.027 亿美元, 去年同期 2620 万美元, 净亏损显著扩大; 持续经营净亏损为-1.24 亿美元, 好于亏损 1.48 亿美元的预期。其中, Mohawk Valley Fab 已小规模投产, 并在本季度贡献了 400 万美元的营收; 设备设计收入达 22 亿美元, 该季度公司签署了价值 22 亿美元的设计合同和价值 10 亿美元的设计合同。指引方面, 公司预计 12 月份季度销售额与上一季度基本持平, 为 1.92 至 2.22 亿美元。上行潜力来自莫霍克谷的收入增长, 12 月份季度的销售额将突破 1,000 万美元, 该工厂预计在 2024 财年第四季度实现 20%利用率目标。当未来工厂满负荷生产时, 新工厂的季度销售额最终将达到 5 亿美元。
晶圆代工厂	台积电	23Q3	23.7-23.9	Q3 营收 172.8 亿美元, 环比增长 10.2%, 同比下滑 14.6%, 营收符合预期, 毛利率为 54.3%, 环比上升 0.2pct, 超出指引。HPC 环比增加+6%, 智能手机环比增加+33%, IoT 环比增加+24%。3nm、5nm、7nm 及更先进的制程营收占比分别为 6%、37%、59%, 预计第四季度市场对 3nm 制成需求持续旺盛, 并成为业绩支撑。AI 需求持续增长, 23 年营收贡献为 6%, 成为一大收入来源。台积电积极参与先进封装环节, 计划于 2024 年实现 CoWoS 产能翻倍, 至 2025 年仍然持续扩充 CoWoS 封装产能。2021-2026 期间 CAGR 为 15%-20%。Q4 营收指引为 188 亿-196 亿美元, 毛利率为 51.5%-53.5%, 营业利润率为 39.5%-41.5%。预计 23 年资本开支大约为 320 亿美元。
	联电	23Q3	23.7-23.9	2023Q3 营收为新台币 570.7 亿元, 较上季的 563 亿元新台币增长 1.4%, 与 2022 年第三季的 753.9 亿元新台币相比减少 24.3%。本季毛利率为 35.9%, 归属母公司净利为新台币 159.7 亿元, 每股普通股获利为新台币 1.29 元。计算和通信领域需求强劲, 因此尽管晶圆出货量下降了 2.3%, 公司收入和毛利率环比持平。从终端市场来看, 计算领域受益于 LCD 控制器、WIFI、Codec 和触控 IC 控制器, 而通信领域则是受益于射频前端 IC 和网络芯片的需求增长。展望第四季度, 由于 PC 和智能手机的紧急订单, 预计需求逐渐稳定, 但客户在库存管理方面还是会采取谨慎和保守的态度。
设备	应用材料	23Q4	23.8-23.10	2023Q4 净销售额为 67.2 亿美元, 与去年同期的 67.49 亿美元相比持平, 高于市场预期 65.4 亿美元; 净利润为 20.04 亿美元, 同比增长 26%, 高于市场预期 16.16 亿美元; 经调整每股盈利 2.12 美元, 高于市场预期 1.99 美元。报告期内, 半导体产品事业部收入 48.83 亿美元, 同比轻微下降 3%。指引方面, 公司预计 2024 财年第一季度净销售额约为 64.7 亿美元, 市场预期净销售额为 63.4 亿美元, 不包括某些项目的每股收益为 1.72-2.08 美元, 每股收益为 1.84 美元。公司首席执行官 Gary Dickerson 认为, 人工智能计算将推动新一轮需求激增。
	拉姆研究	23Q3	23.7-23.9	2023Q3 营业收入为 34.82 亿美元, 去年同期收入为 50.74 亿美元, 同比下降 31.38%; 毛利为 16.55 亿美元; 营业利润为 10.23 亿美元; 净利润为 8.87 亿美元, 去年同期净利润为 14.26 亿美元, 同比减少 37.76%; 基本每股收益为 6.69 美元, 去年同期为

				10.42 美元，同比下降 35.80%。其中中国销售占比大增至近五成，目预期中国业务将继续维持强劲。拉姆研究院总裁兼 CEO 表示，拉姆研究院在本季度取得了强劲的业绩。拉姆研究院预计下季度收入 37 亿美元(正/负 3 亿美元)，每股盈余为 6.25-7.75 美元。
	东京电子	24Q2	23.7-23.9	FY24Q2 实现营收 4278 亿日元，同比减少 39.7%，环比增加 9.2%；毛利 1897 亿日元，环比增加 16.9%，同比减少 42.2%；毛利率 44.3%。FY24H1 整体营收 8195，同比减少 20.1%；毛利 3520 亿日元，同比减少 22.7%。分地区销售情况，中国、韩国、北美占据前三，销售占比分别为 42.8%、15.8%、11.1%。分应用来看，半导体生产设备销售份额 DRAM、Non-volatile memory、逻辑代工厂及其他分别占据 28%、5%、67%。指引方面，FY24 全年预计营收 17300 亿元，毛利率为 44.1%，资本开支为 1240 亿日元，折旧为 570 亿日元。
	ASML	23Q3	23.7-23.9	2023Q3 公司净销售额为 66.73 亿欧元，去年同期为 69.02 亿欧元，同比减少 0.3%；净利润为 18.93 亿欧元，去年同期为 19.42 亿欧元，2.5%；每股盈利 4.81 欧元，去年同期为 4.93 欧元，同比减少 2.4%；毛利率为 51.9%，去年同期为 51.3%。今年三季度新增订单金额为 26 亿欧元，同比大幅减少 42.17%，其中 5 亿欧元为 EUV 光刻机订单。中国市场在 ASML 的销售额占比较高，收入占比达到 46%。预估第 4 季度销售净额约 67-71 亿欧元，毛利率在 50%-51% 之间，研发成本约为 10.3 亿欧元，SG&A 成本约为 2.85 亿欧元，预估 2023 年营收同比增长 30% 以上，全年毛利率达到 51%。公司首席执行官 Peter Wennink 表示，由于今年基本交付了中国大陆客户预付的 DUV 积压订单，叠加出口管制新规，公司明年 DUV 收入将会减少，总销售收入可能会有所下降。
传感器	通用电气	23Q3	23.7-23.9	2023Q3 内生性营收为 163 亿美元，同比增长 18%，好于市场预期；调整后每股收益为 0.82 美元，好于市场预期，上年同期为 0.17 美元；按业务划分，航空航天部门营收同比增长 25%至 84.09 亿美元，利润同比增长 33%至 17.12 亿美元，订单总额同比增长 34%至 97.93 亿美元；可再生能源部门营收同比增长 15%至 41.51 亿美元，亏损 3.17 亿美元，同比收窄 66%，订单总额同比增长 5%至 39.18 亿美元；能源部门营收同比增长 13%至 39.74 亿美元，利润同比增长 69%至 2.38 亿美元，订单总额同比增长 2%至 42.57 亿美元。展望未来，公司预计 2023 年全年调整后的每股收益为 2.55-2.65 美元，此前预期为 2.10-2.30 美元，自由现金流为 47 亿-51 亿美元，此前预期为 41 亿-46 亿美元。此外，该公司预计全年内生性营收将实现低双位数增长。
手机芯片	高通	23Q4	23.7-23.9	FY23Q4 实现营收 86.3 亿美元，去年同期 114 亿美元，同比下降 24%，高于市场预期 85.1 亿美元；摊薄后每股收益 1.32 美元，上年同期 2.54 美元，同比下降 48%，高于市场预期 1.92 美元；净利润 14.89 亿美元，上年同期 28.73 亿美元，同比下降 48%，低于市场预期 16.3 亿美元。分业务来看，高通出售智能手机、汽车和其他智能设备芯片的业务 QCT 营收 73.74 亿美元，上年同期 99.04 亿美元，同比下降 26%，高于市场预期的 72.6 亿美元。其中，手机业务的营收为 54.56 亿美元，同比下降 27%，IoT 业务营收 13.83 亿美元，同比下降 31%，汽车业务营收 5.35 亿美元，同比增加 15%；涉及知识产权授权的高通技术许可业务 QTL 三季度营收为 12.62 亿美元，上年同期 14.41 亿美元，同比下降 12%，略高于市场预期的 12.5 亿美元。展望未来，预计 FY24Q1 营收 91-99 亿美元，市场预期 92.6 亿美元，调整后每股收益 2.25-2.45 美元，市场预期 2.25 美元。

资料来源：各公司官网，山西证券研究所

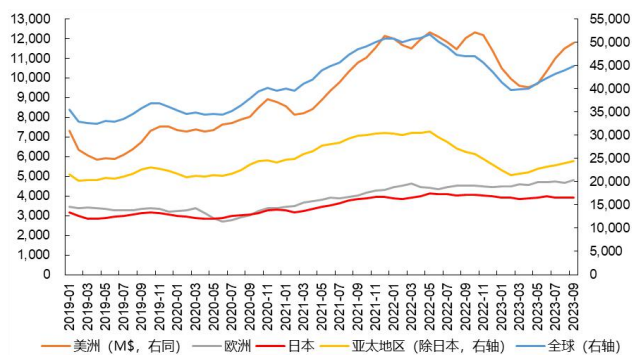
2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



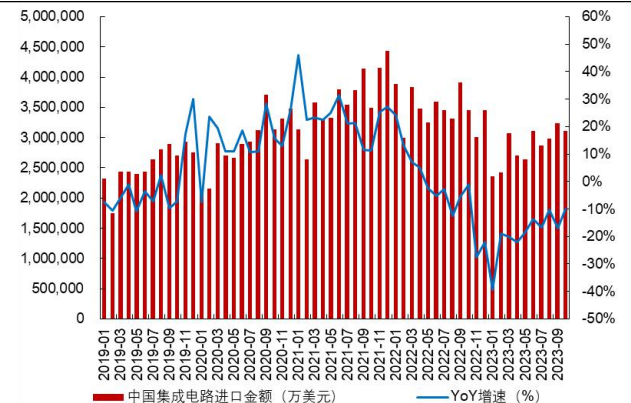
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 10：分地区半导体销售额



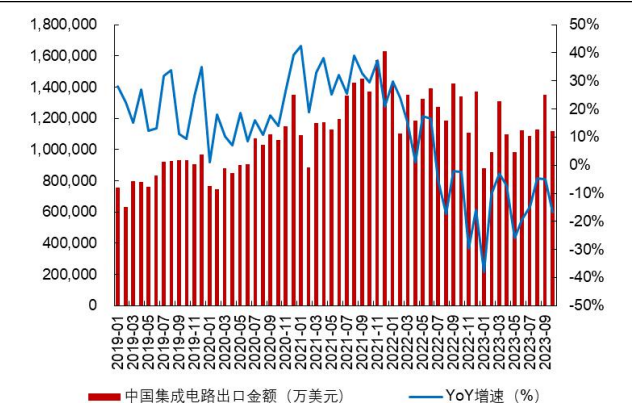
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 11：中国集成电路行业进口情况



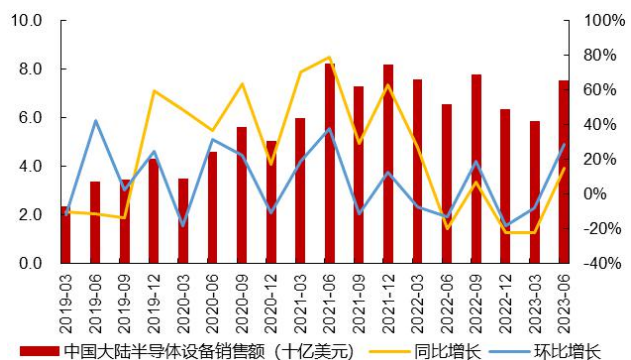
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 12：中国集成电路行业出口情况



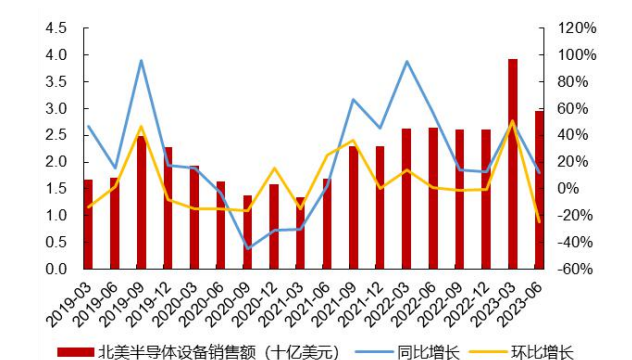
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 13：中国大陆半导体设备销售额



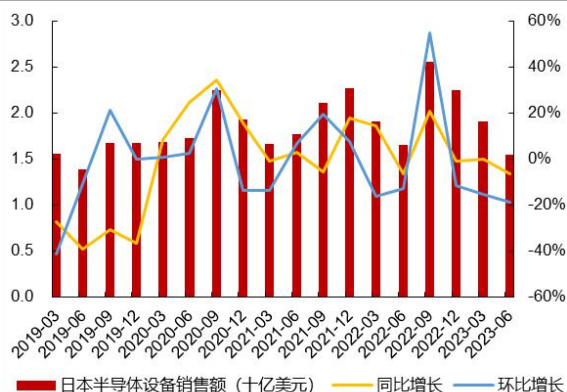
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 14：北美半导体设备销售额



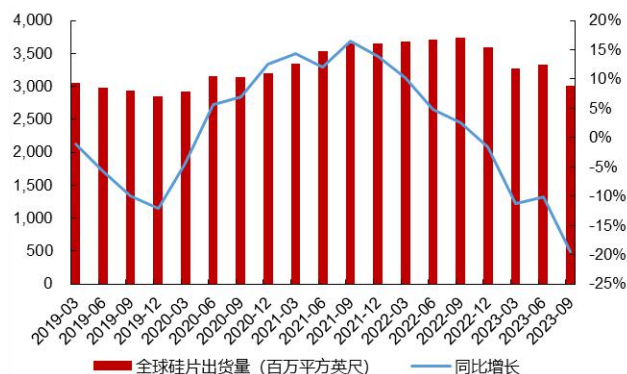
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 15：日本半导体设备销售额



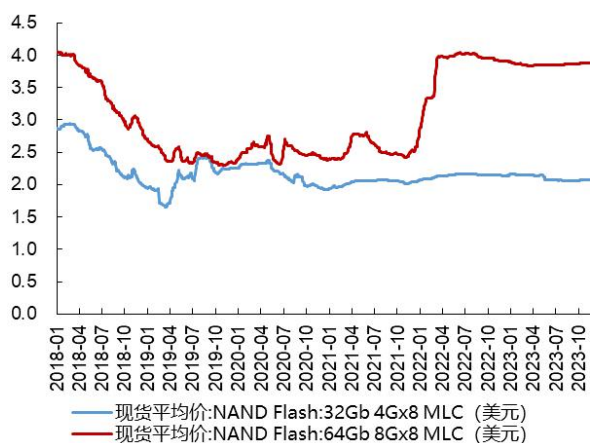
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 16：全球硅片出货面积



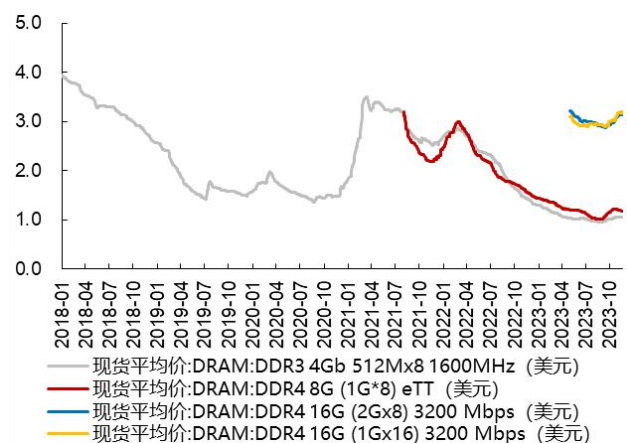
资料来源：SEMI，山西证券研究所

图 17：NAND 现货平均价



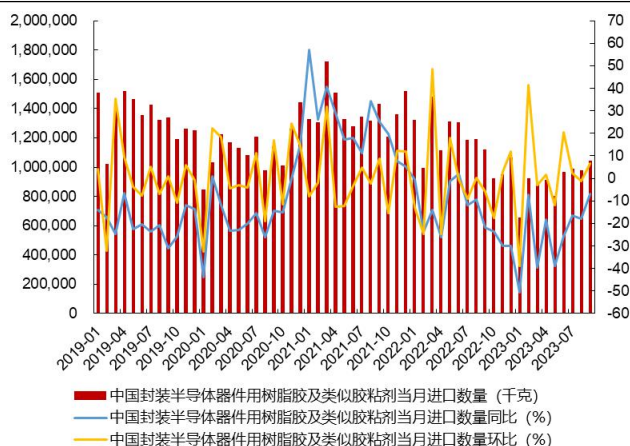
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 18：DRAM 现货平均价



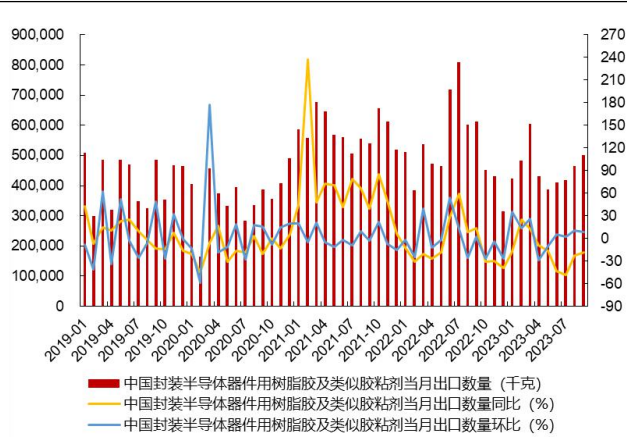
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 19：半导体封装材料进口情况



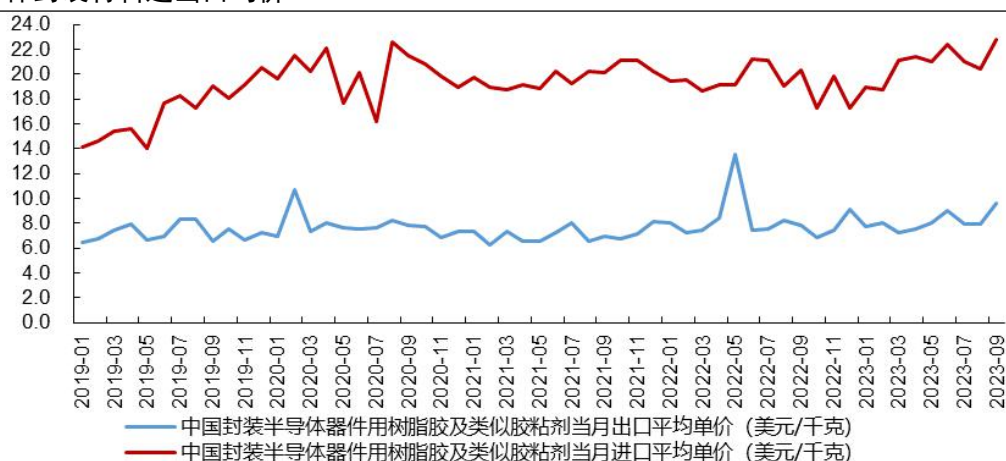
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 20：半导体封装材料出口情况



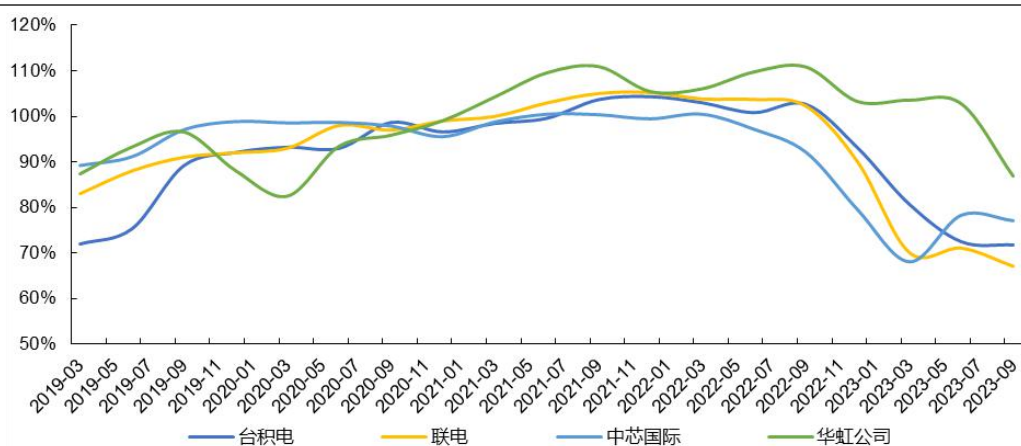
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 21：半导体封装材料进出口均价



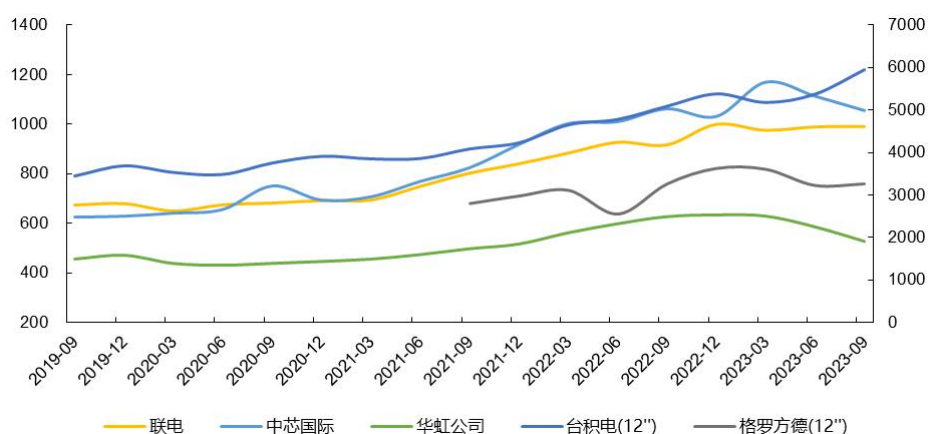
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 22：晶圆厂稼动率 (%)



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP (美元/片)



资料来源：各公司季报，山西证券研究所

表 2：主要半导体产品货期

低压MOSFET货期（周）				高压MOSFET货期（周）				IGBT货期（周）			
供应商	3Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	3Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	3Q23	货期趋势	价格趋势
Infineon	18-48	↗	↔	Infineon	39-56	↗	↔	Fairchild	39-52	↔	↔
Diodes	18-52	↗	SMA	On Semi	36-52	↗	↔	Infineon	39-50	↔	↔
On Semi	26-52	↗	↔	IXYS	50-54	↔	↔	STMicro	47-52	↔	↔
Nexperia	16-52	↗	↔	STMicro	39-52	↗	↔				
8位MCU货期（周）				32位MCU货期（周）				FPGA货期（周）			
供应商	3Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	3Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	3Q23	货期趋势	价格趋势
NXP	26-52	↗	↔	NXP	18-52	↗	↔	Lattice	28-42	↗	↔
Microchip	26-52+	↗	↔	Microchip	26-52+	↗	↔	Microsemi	32-42	↗	↔
Renesas	18-24	↗	↔	Renesas	18-26	↔	↔				
传感器货期（周）				信号链（放大器和数据转换器）货期（周）				NAND闪存货期（周）			
供应商	3Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	3Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	3Q23	货期趋势	价格趋势
Melexis	12-35	↗	↔	On Semi	26-42	↔	↔	Macronix	8-12	↔	SMA
NXP	16-52	↔	↔	Renesas	36-40	↔	↔	Alliance Memory	8-24	↗	↔
Infineon	18-52	↔	↗								

资料来源：富昌电子，山西证券研究所

表 3：主要半导体公司存货周转天数

海外功率公司			国内功率公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	3Q23	趋势迷你图
Infineon	153		斯达半导	180	
On Semi	158		士兰微	160	
			华润微	107	
海外模拟芯片公司			国内模拟芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	3Q23	趋势迷你图
TI	200		圣邦股份	221	
ADI	130		思瑞浦	355	
海外存储芯片公司			国内存储芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	3Q23	趋势迷你图
Micron	170		北京君正	277	
Samsung	107		兆易创新	208	
			澜起科技	293	
海外MCU芯片公司			国内MCU芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	3Q23	趋势迷你图
NXP	134		北京君正	277	
Microchip	165		兆易创新	208	
Renesas	100		中微半导	364	
国内设备公司			国内被动元件公司		
供应商	3Q23	趋势迷你图	供应商	3Q23	趋势迷你图
北方华创	391		风华高科	67	
芯源微	487		三环集团	177	
长川科技	984		法拉电子	107	
中微公司	432		泰晶科技	82	
国内光电公司			国内消费电子公司		
供应商	3Q23	趋势迷你图	供应商	3Q23	趋势迷你图
三安光电	148		歌尔股份	46	
乾照光电	72		工业富联	61	
聚灿光电	38		立讯精密	57	
京东方A	60				

资料来源：公司季报（海外公司），Wind（国内公司），山西证券研究所

表 4：主要半导体公司毛利率情况

海外功率公司			国内功率公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	3Q23	趋势迷你图
Infineon	43.60%		斯达半导	36.59%	
On Semi	47.30%		士兰微	21.87%	
			华润微	31.66%	
海外模拟芯片公司			国内模拟芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	3Q23	趋势迷你图
TI	62.11%		圣邦股份	49.01%	
ADI	63.80%		思瑞浦	57.85%	
海外存储芯片公司			国内存储芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	3Q23	趋势迷你图
Micron	-9.00%		北京君正	37.11%	
Samsung	30.85%		兆易创新	36.36%	
			澜起科技	64.80%	
海外MCU芯片公司			国内MCU芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	3Q23	趋势迷你图
NXP	58.50%		北京君正	37.11%	
Microchip	67.80%		兆易创新	36.36%	
Renesas	57.90%		中微半导	16.05%	
国内设备公司			国内被动元件公司		
供应商	3Q23	趋势迷你图	供应商	3Q23	趋势迷你图
北方华创	36.37%		风华高科	14.00%	
芯源微	41.12%		三环集团	39.88%	
长川科技	61.10%		法拉电子	38.51%	
中微公司	45.74%		泰晶科技	25.64%	
			台湾晶技	45.77%	
国内光电公司			国内消费电子公司		
供应商	3Q23	趋势迷你图	供应商	3Q23	趋势迷你图
三安光电	8.11%		歌尔股份	10.15%	
乾照光电	13.90%		工业富联	9.29%	
聚灿光电	9.68%		立讯精密	13.76%	
京东方A	14.83%				

资料来源：公司季报（海外公司），Wind（国内公司），山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 5：本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2023 年 11 月 13 日				兴森科技	
2023 年 11 月 14 日					
2023 年 11 月 15 日				兴瑞科技	
2023 年 11 月 16 日					
2023 年 11 月 17 日	芯瑞达				
2023 年 11 月 18 日					

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 6：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2023 年 11 月 13 日	联电、世界先进及力积电等晶圆代工厂成熟制程厂商为抢救产能利用率，大砍明年首季报价，幅度达二位数百分比，专案客户降幅更高达 15%至 20%，借此“以价换量”，降价幅度是疫情后最大。业界人士透露，台面上仅台积电价格仍坚挺，其他厂商几乎无一幸免。	界面新闻
2023 年 11 月 13 日	继英伟达 10 月确定扩大下单后，业界传出，苹果、超威、博通、迈威尔等重量级客户近期亦对台积电追单，台积电为应对上述五大客户需求，加快 CoWoS 先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约 20%达 3.5 万片。与此同时，台积电也进一步对设备厂商追加订单，已有多家先进封装设备厂陆续接获台积电通知，必须全力支援其扩大先进封装产能。业内预期，台积电对 CoWoS 相关设备厂商追加的订单，将从明年上半年开始装机并进入试产，明年下半年开始投入产能。	科创板日报
2023 年 11 月 14 日	半导体巨头英伟达发布了新一代人工智能(AI)芯片 H200，旨在培训和部署各种人工智能模型。新的 H200 芯片是当前用于训练最先进大语言模型 H100 芯片的升级产品（基于 Hopper 架构），集成了 141GB 的内存，且是 HBM3e 内存的芯片。借助 HBM3e，英伟达 H200 以每秒 4.8TB 的速度提供 141GB 的内存，与 A100 相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了 2.4 倍。相比 H100 来说，H200 在用于推理或生成问题答案时，性能较 H100 提高 60%至 90%。H200 预计将于 2024 年第二季度上市，将与 AMD 的 MI300X GPU 展开竞争。同时，英伟达透露将于明年推出 Blackwell 架构 B100 GPU，其 AI 表现性能将是 Hopper 架构 H200 GPU 两倍以上，计划生产时间点预计为 2024 年 Q2。	财联社
2023 年 11 月 14 日	铠侠今日发布了最新季度财报，声称由于智能手机和个人电脑（PC）内存芯片需求下滑，该公司第二季度出现了 1008 亿日元的运营亏损。铠侠表示，由于平均销售价格上涨以及日元走弱的推动，营收环比下降，但亏损较小。铠侠表示，NAND 销售价格已经触底，预计明年智能手机和 PC 的出货量将增加。	IT 之家
2023 年 11 月 16 日	微软在 Ignite 2023 技术大会上首次推出两款定制芯片，用于强化 Azure AI 和 Microsoft Copilot 服务，分别为 Azure Maia 100 及 Azure Cobalt 100。其中 Azure Maia 100 是一款 AI 加速器芯片，用于 OpenAI 模型、Bing、GitHub Copilot 和 ChatGPT 等 AI 工作负载运行云端训练和推理，采用台积电的 5 纳米工艺制造，有 1050 亿个晶体管，比 AMD 挑战英伟达的 AI 芯片 MI300X 的 1530 亿个晶体管少约 30%；Azure Cobalt 100 是一款 Arm 芯片，专门用于在微软 Cloud 上运行通用计算工作负载，它总共拥有 128 个 Neoverse N2 内核，支持 12 通道 DDR5 内存，与即将推出的 ARM 服务器芯片相比，每个内核的性能提高了 40%。	IT 之家
2023 年 11 月 17 日	由于替换高通组件的复杂性，苹果在其数十亿美元的 iPhone 调制解调器芯片自研计划中进一步落后。知情人士透露，苹果已经推迟了到明年准备好自研芯片的计划，现在很可能无法实现在 2025 年春季之前发货的目标。这将至少推迟到 2025 年底或 2026 年初，也就是苹果最近与高通延长合同的最后一年。	财联社

资料来源：界面新闻，科创板日报，财联社，IT 之家，山西证券研究所

3.3 公司公告

表 7：本周重要公司公告

公司	时间	公告类型	公告摘要
联创电子	2023 年 11 月 12 日	股权激励	拟向激励对象授予限制性股票数量为 10.00 万股，占授予前公司总股本的 0.01%，授予价格为 9.21 元/股，限制性股票上市流通日期为 2023 年 11 月 15 日。
富满微	2023 年 11 月 12 日	股权激励	拟向激励对象授予限制性股票总计 1000 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 21,772.45 万股的 4.59%，授予价格为 25.56 元/股。
炬光科技	2023 年 11 月 12 日	回购股权	以集中竞价交易方式首次回购公司股份，股票数量为 250,000 股，占公司总股本的 0.2767%，回购成交的最高价为 117.50 元/股，最低价为 111.94 元/股，支付的资金总额为人民币 28,607,829.19 元。
江波龙	2023 年 11 月 12 日	资金投向	公司拟使用部分超募资金向全资子公司上海慧忆半导体有限公司增资或借款以收购 SMART Modular Technologies do Brasil - Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其子公司的 81%股权，超募资金数目为人民币 26,440.77 万元。投资目的：拓展拉丁美洲市场布局；增强供应链韧性。
英飞拓	2023 年 11 月 12 日	权益变动	公司拟公开挂牌转让所持有的全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%的股权，挂牌底价定为 20,996.00 万元，本次股权出售事项完成后，公司仍持有英飞拓系统 19%的股权，英飞拓系统将不再纳入公司合并报表范围。
敏芯股份	2023 年 11 月 12 日	股权激励	拟向激励对象预留授予股票期权，授予数量为 6.0227 万份，行权价格为 42.02 元/份，预留授予日为 2023 年 11 月 10 日。
敏芯股份	2023 年 11 月 12 日	股权激励	作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。合计股数 5.75 万股。作废原因：激励对象不符合激励资格。
风华高科	2023 年 11 月 13 日	人事变动	吴泽林先生因年龄原因，向董事会申请辞去公司董事长职务。
ST 美讯	2023 年 11 月 13 日	人事变动	同意聘任王伟静女士为公司董事会秘书，公司财务总监郭晨先生不再代行董事会秘书职责。
捷捷微电	2023 年 11 月 13 日	股权激励	回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，数量为 25,462 股，回购价格为 11.7923 元/股，回购总金额 300,255.54 元。作废原因：激励对象离职导致不符合激励条件。
木林森	2023 年 11 月 13 日	资金投向	公司拟终止“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”，全部剩余募集资金 58,007.58 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。终止原因：外部宏观及市场环境较原募投项目确定时发生诸多变化。
天承科技	2023 年 11 月 13 日	资金投向	广东天承科技股份有限公司拟在泰国投资建设生产基地，投资金额为人民币 1 亿元。投资原因：进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务。
天承科技	2023 年 11 月 13 日	资金投向	广东天承科技股份有限公司拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司上海天承科技有限公司。投资原因：经营和战略发展的需要；加强公司的核心竞争力。
嘉元科技	2023 年 11 月 13 日	回购股权	以集中竞价交易方式首次回购公司股份，股票数量为 240,405 股，占公司总股本 426,238,028 股的比例为 0.0564%，回购成交最高价为 21.66 元/股，最低价为 21.45 元/股，支付资金总额为人民币 5,182,337.20 元。
泰晶科技	2023 年 11 月 13 日	股权激励	回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，数量为 20,580 股，回购注销时间为 2023 年 11 月 16 日。注销原因：激励对象离职导致不符合激励条

公司	时间	公告类型	公告摘要
			件。
艾华集团	2023 年 11 月 13 日	资金投向	公司全资子公司湖南艾源达电容器有限公司投资建设“薄膜电容器及新材料项目”，项目计划总投资 45,600 万元。投资原因：公司产业规划和发展需要。
兴森科技	2023 年 11 月 13 日	收购兼并	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司同意以挂牌底价 300,389,041.10 元进场参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司的少数股东科学城（广州）投资集团有限公司所持有的广州兴科 25%股权。投资原因：符合公司整体发展战略规划。
新洁能	2023 年 11 月 13 日	股权激励	回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，数量为 12,250 股，回购注销时间为 2023 年 11 月 16 日。注销原因：激励对象离职导致不符合激励条件。
杰美特	2023 年 11 月 13 日	资金投向	同意公司全资子公司东莞市杰之洋塑胶实业有限公司与无锡金可昇模塑科技有限公司共同投资设立合资公司“东莞市杰美华新材料科技有限公司”，合资公司的注册资本为 500 万元，其中杰之洋以自有资金出资 255 万元，占比 51%；金可昇出资 245 万元，占比 49%。投资原因：公司战略发展规划，结合自身经营发展需要。
合力泰	2023 年 11 月 13 日	个股其他公告	公司控股股东福建省电子信息集团决定解除并终止《股份转让协议》及与股份转让相关的其他权利和义务约定。终止原因：交易对手深圳慧舍科技合伙企业违约。
世运电路	2023 年 11 月 13 日	股权激励	注销部分已获授但尚未行权的股票期权，股票期权数量合计 809,800。作废原因：激励对象离职导致不符合激励条件。
世运电路	2023 年 11 月 13 日	股权激励	2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期，行权数量为 4,557,060 份，行权价格为 12.88 元/份，授予日为 2022 年 9 月 26 日。
永新光学	2023 年 11 月 13 日	股本变动	解除限售股份数量为 480,000 股，占公司总股本的 0.43%，上市流通日期为 2023 年 11 月 17 日。
瀛通通讯	2023 年 11 月 14 日	股份增减持	公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士的一致行动人左贵明先生、左娟妹女士、左美丰女士提前终止股份减持计划。终止原因：根据自身资金安排及市场环境判断。
敏芯股份	2023 年 11 月 14 日	增发发行	拟向特定对象发行股票，本次发行募集资金总额为人民币 14,099.99 万元，拟用于年产车用及工业级传感器 600 万只生产研发项目和微差压传感器研发生产项目。
晶晨股份	2023 年 11 月 14 日	利润分配	拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），公司总股本 416,319,868 股，以此计算合计拟派发现金红利 208,159,934.00 元（含税），占公司 2023 年前三季度合并报表归属母公司股东净利润的 66.35%。
富瀚微	2023 年 11 月 14 日	股份增减持	公司控股股东、实际控制人杨小奇先生及其一致行动人陈春梅女士、杰智控股有限公司、龚传军先生自愿承诺自 2023 年 11 月 14 日起 6 个月内不以任何方式减持所持有的富瀚微股份。原因：基于对富瀚微未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可。
鑫汇科	2023 年 11 月 14 日	人事变动	山江林先生因个人原因辞去副总裁职务。
维信诺	2023 年 11 月 14 日	股本变动	解除限售股票数量 3,949,671 股，占公司目前总股本比例为 0.2844%，股票上市流通日为 2023 年 11 月 17 日。
思瑞浦	2023 年 11 月 14 日	股权激励	2020 年限制性股票激励计划预留授予部分股票拟归属并上市流通，本次归属股票数量为 57,182 股，占公司股本的 0.0432%。预留归属股份上市流通时间

公司	时间	公告类型	公告摘要
			2023 年 11 月 17 日。
美芯晟	2023 年 11 月 14 日	股本变动	首次公开发行网下配售限售股上市流通，数量为 1,161,683 股，占公司股本总数的 1.4519%，股票上市流通日期为 2023 年 11 月 22 日。
博硕科技	2023 年 11 月 14 日	股权激励	回购注销部分已获授未解除限售的限制性股票，股票数量为 6,000 股。回购注销原因：激励对象离职导致不符合激励条件。
鸿利智汇	2023 年 11 月 14 日	公司资料变更	鸿利智汇集团股份有限公司同意注销孙公司江西鸿利智达光电有限公司。
超频三	2023 年 11 月 14 日	人事变动	因任期届满，张正华先生不再担任公司副总经理职务。
甬矽电子	2023 年 11 月 14 日	资金投向	公司拟以控股子公司甬矽半导体作为项目实施主体，投资建设高密度及混合集成电路封装测试项目，项目总金额预计不超过人民币 215,651 万元。投资原因：推进公司长远发展战略规划，提升公司的核心竞争力。
视源股份	2023 年 11 月 14 日	资金投向	同意公司以自有或自筹资金投资人民币 42 亿元建设“视源股份全球总部基地项目”。投资原因：巩固技术和产品领先优势。
深纺织 A	2023 年 11 月 15 日	停牌提示	公司股票将自 2023 年 11 月 15 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日。
兴瑞科技	2023 年 11 月 15 日	收购兼并	宁波兴瑞电子科技有限公司拟以自有资金向关联方宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司收购其持有慈溪骏瑞房屋租赁有限公司 100%股权，慈溪骏瑞 100%股权的转让价款为 16,262,094.48 元。投资原因：公司经营发展需要。
兴瑞科技	2023 年 11 月 15 日	收购兼并	宁波兴瑞电子科技有限公司同意终止以评估价格 8,310,080.00 元向关联方慈溪骏瑞房屋租赁有限公司购买工业房地产。终止原因：标的资产变更权属手续时间较长，公司产能扩建时间迫切需求。
联动科技	2023 年 11 月 15 日	股权激励	拟向激励对象授予权益总计不超过 322.11 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,960.0268 万股的 4.63%，授予价格为 34.06 元/股。
智动力	2023 年 11 月 15 日	人事变动	杨依明先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后其不再担任公司任何职务。公司董事会同意聘任吴雄仰先生担任公司总经理职务。
广信材料	2023 年 11 月 15 日	股本变动	向特定对象发行股票，发行数量为 5,920,663 股，发行价格为 16.89 元/股，募集资金总额 99,999,998.07 元，股票上市流通日期 2023 年 11 月 17 日。
联创光电	2023 年 11 月 15 日	股份增减持	公司董事会秘书邓惠霞女士增持公司股份 14,200 股，占公司目前总股本的 0.0031%。增持原因：对公司内在价值的认可、未来持续稳定发展的信心、长期投资价值及战略规划的认可。
汇创达	2023 年 11 月 15 日	股本变动	解除首次公开发行前已发行的部分限售股份数量为 90,766,558 股，占公司总股本的 52.4744%，上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日。
中微公司	2023 年 11 月 15 日	股权激励	本次股票增值权行权数量为 13.67 万份，行权日为 2023 年 11 月 14 日。
万润股份	2023 年 11 月 15 日	股本变动	解除限售股票数量为 6,925,050 股，占公司目前总股本的 0.7445%，股票上市流通日为 2023 年 11 月 17 日。
铜峰电子	2023 年 11 月 15 日	股权激励	拟向激励对象授予 1,137.30 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 62,167.6155 万股的 1.83%，授予价格为每股 3.91 元。
联创电子	2023 年 11 月 15 日	股权激励	回购注销已获授但未获准解除限售的限制性股票，股票数量为 22.40 万股。回购注销原因：激励对象不再具备激励资格。
晶升股份	2023 年 11 月 15 日	人事变动	聘任吴春生先生担任公司副总经理。
宸展光电	2023 年 11 月 15 日	股本变动	首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为 50,284,256 股，占公司总股本的 30.8428%。股份上市流通日期为 2023 年 11 月 20 日。

公司	时间	公告类型	公告摘要
蓝黛科技	2023 年 11 月 15 日	股权激励	回购注销部分限制性股票，股票数量为 47 万股。回购注销原因：激励对象不符合激励条件。
莱特光电	2023 年 11 月 15 日	人事变动	聘任李红燕女士为公司副总经理。
景旺电子	2023 年 11 月 15 日	停牌提示	“景 20 转债”因转股价格调整于 2023 年 11 月 16 日停牌，复牌日为 2023 年 11 月 17 日。
世运电路	2023 年 11 月 15 日	停牌提示	公司 A 股股票、可转债债券以及可转债转股于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日停牌两个交易日。
帝科股份	2023 年 11 月 15 日	股权激励	拟授予激励对象的限制性股票数量为 356.2561 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 10,025.00 万股的 3.55%。授予价格为 35.62 元/股。
唯特偶	2023 年 11 月 16 日	签订协议	深圳市唯特偶新材料股份有限公司与南方科技大学签署了决定共同成立“南科大材料系-唯特偶新材料联合实验室”，合作有效期为 5 年。
格科微	2023 年 11 月 16 日	股本变动	本次行权股票数量为 1,795,000 股，占行权前公司已发行股份总数的比例为 0.07%，行权股票上市流通时间为 2026 年 11 月 16 日。
贤丰控股	2023 年 11 月 16 日	资金投向	公司同意香港亚美通过减资退出丰盈租赁，丰盈租赁注册资本减少至 22,500 万元，本次减资完成后，丰盈租赁将成为公司全资子公司。
北方华创	2023 年 11 月 16 日	股份增减持	公司实际控制人北京电控将七星集团持有的北方华创 33.61%的股权无偿划转至北京电控。本次股权无偿划转完成后，公司控股股东将由七星集团变更为北京电控，实际控制人仍为北京电控。
中微公司	2023 年 11 月 16 日	股本变动	本次拟归属股票数量为 108.0900 万股，约占归属前公司总股本的比例约为 0.1748%，股票上市流通时间为 2023 年 11 月 21 日。
晶丰明源	2023 年 11 月 16 日	股本变动	本次拟归属股票数量为 2,280 股，占归属前公司总股本的比例为 0.0036%，股票上市流通时间为 2023 年 11 月 21 日。
歌尔股份	2023 年 11 月 16 日	回购股权	首次回购公司股份 1,172,400 股，占公司目前总股本的比例为 0.03%，最高成交价为 19.00 元/股，最低成交价为 18.90 元/股，支付金额为 22,208,928 元。
显盈科技	2023 年 11 月 16 日	可转债发行上市	拟向不特定对象发行可转债拟募集资金不超过人民币 42,000.00 万元，拟用于越南生产基地建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。
京东方 A	2023 年 11 月 16 日	股权激励	回购注销部分限制性股票，股票数量为 5,349,564 股。回购注销原因：激励对象不再具备激励资格。
好上好	2023 年 11 月 16 日	股本变动	首次公开发行前已发行股份上市流通，股份数量为 26,996,981 股，占公司总股本 19.11%，股份上市流通日期为 2023 年 11 月 21 日。
*ST 长方	2023 年 11 月 16 日	权益变动	公司原控股股东祥平科技持有的公司 78,478,085 股股份被法院司法拍卖，祥平科技不再持有公司股份，昌鑫旺在持股数量及比例不变的情况下，被动成为公司第一大股东。
联创光电	2023 年 11 月 16 日	关联交易	公司控股子公司厦门华联电子股份有限公司拟引入投资者进行增资扩股。其中，引入不超过 5 家投资者增资不超过 4,000 万股，引入华联电子的员工持股平台厦门华智投资合伙企业（有限合伙）增资不超过 800 万股，合计增资扩股的总股数不超过 4,800 万股，预计募集资金总额不超过 3.05 亿元。
气派科技	2023 年 11 月 16 日	员工持股	本员工持股计划合计受让的股份总数不超过 102.1898 万股，占公司当前股本总额 10,627.00 万股的 0.96%，价格为 13.73 元/股。
沃尔核材	2023 年 11 月 16 日	股份增减持	在本次减持计划实施期间，向克双先生及马葵女士未进行股份减持，其本次减持计划前后的持股数量未发生变化。
苏州固锔	2023 年 11 月 16 日	股权激励	2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期，可行权的股票期

公司	时间	公告类型	公告摘要
			权数量共计 168.92 万份, 占公司目前总股本比例为 0.21%, 行权价格为 10.29 元/份, 实际可行权期限为 2023 年 11 月 17 日-2024 年 10 月 25 日。
华勤技术	2023 年 11 月 16 日	人事变动	同意聘任邓治国、廖浩然、汪启军为公司副总经理。
华体科技	2023 年 11 月 16 日	权益变动	北京泰德圣以集中竞价的方式将公司股份数量从 9,362,139 股变动至 8,158,839 股, 权益变动股份数为 1,203,300 股。占公司总股本的比例由 5.74% 变动至 4.99%。
南亚新材	2023 年 11 月 16 日	增发发行	2022 年度向特定对象发行 A 股股票, 鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 5 月 10 日实施完毕, 本次股票的发行价格由 16.42 元/股调整为 16.17 元/股。
芯瑞达	2023 年 11 月 17 日	股份增减持	公司总经理计划增持公司股份, 计划合计增持金额不低于 30 万元。增持原因: 基于对安徽芯瑞达科技股份有限公司未来发展前景的信心以及价值的高度认可。
天岳先进	2023 年 11 月 17 日	回购股权	宗艳民先生提议公司回购公司已发行的部分人民币普通股 (A 股) 股份, 回购股份的资金总额不低于人民币 10,000.00 万元 (含), 不超过人民币 20,000.00 万元 (含), 回购的股份未来将用于股权激励及/或员工持股计划。
峰昭科技	2023 年 11 月 17 日	回购股权	公司实际控制人、董事长 BILEI 先生提议回购公司股份, 回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元, 不超过人民币 3,000 万元, 回购的股份未来将用于股权激励及/或员工持股计划。
和辉光电	2023 年 11 月 17 日	个股其他公告	公司控股股东上海联和投资有限公司承诺将其持有的公司首次公开发行前股份 8,057,201,900 股 (占公司当前总股本的 58.15%) 的锁定期, 自原限售期满之日起自愿延长 12 个月至 2025 年 5 月 28 日。
石英股份	2023 年 11 月 17 日	回购股权	公司控股股东、实控人、董事长、总经理陈士斌提议公司回购股份, 回购资金总额不低于 1 亿元 (含), 不超过 2 亿元 (含), 回购的股份未来将用于股权激励及/或员工持股计划。
福日电子	2023 年 11 月 17 日	个股其他公告	对“广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目”达到预定可使用状态的日期由 2023 年 11 月 19 日延期至 2024 年 11 月 19 日, 延期原因: 募投项目产品需求变化不及预期, 公司现有产能已经能够满足在手订单需求, 后续承接增量订单存在不确定性。
阿石创	2023 年 11 月 17 日	政策影响	公司自 2023 年 7 月 24 日至 2023 年 11 月 16 日获得与收益相关的政府补助资金人民币 1,418,073.78 元, 均计入其他收益。上述政府补助预计将会增加公司 2023 年度利润总额 1,418,073.78 元。
统联精密	2023 年 11 月 17 日	股本变动	本次拟归属股票数量 28.5568 万股, 占归属前公司总股本的比例约为 0.18%, 归属股票上市流通时间为 2023 年 11 月 22 日。
奥士康	2023 年 11 月 17 日	利润分配	2023 年前三季度权益分派, 以公司目前总股本 317,360,504 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.77 元 (含税), 共派发现金红利 214,853,061.21 元。
泰晶科技	2023 年 11 月 17 日	人事变动	解聘毛润泽先生的公司副总经理职务, 聘任钟院华先生和时承虎先生为公司副总经理。
英飞拓	2023 年 11 月 17 日	权益变动	深圳英飞拓科技股份有限公司公开挂牌转让所持有的全资子公司新普互联 (北京) 科技有限公司 100% 的股权, 挂牌底价定为 42,174.70 万元, 同时公司拟以债转股方式对新普互联增资 56,722.35 万元。原因: 进一步整合公司资源, 优化公司业务结构, 聚焦优质主业。

公司	时间	公告类型	公告摘要
南大光电	2023 年 11 月 17 日	可转债付息 兑付	“南电转债” 将于 2023 年 11 月 24 日按面值支付第一年利息，每 10 张 “南电转债”（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税），债权登记日为 2023 年 11 月 23 日，付息日、除息日为 2023 年 11 月 24 日。

资料来源：Wind，山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。

分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：**——公司评级**

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明:

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息,但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期,公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则,公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明,禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构;禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定,且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人,提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所:

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话: 0351-8686981

<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区林创路新一代产业园 5 栋 17 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

